



TIR® 500M1 是一种适用于高阶散热、封装、低温焊接及异材质贴合等关键应用的高性能材料。其不仅具备良好的导热性能，更兼具优异的可塑性，使其在导热界面材料中占据重要地位。通过对接界面间隙的有效填充，铜能够显著降低接触热阻，提升整体散热模块的导热效率，因而非常适用于高阶散热模块系统中作为导热界面材料使用。

特性

- 》低热阻
- 》极高的光渗透性
- 》优异的导电性能
- 》良好的延展性与可塑性

应用

- 》散热系统
- 》半导体封装与测试
- 》光电面板
- 》密封与贴合工艺

TIR® 500M1 特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	银白色	目视
形态	片状固体	目视
结构&成份	铜	-
纯度 (%)	> 99	-
厚度范围 (inch/mm)	0.002~0.039 0.05~1.00	ASTM D374
密度 (g/cm³) @25°C	7.31	ASTM D792
导热系数 (W/m·K) @25°C	81.0	ISO22007
比热容 (J/g·°C) @25°C	0.233~0.239	ASTM E1269
电阻率 (Ω·m)	< 10 ⁻⁴	ASTM D257
相变温度 (°C)	156	ASTM D3418
建议使用温度范围 (°C)	-50~150	-
保质期 (月) (40°C以下)	12	-

注意事项

1. 操作时建议配戴手套与防护眼镜
2. 操作时避免过度拉伸或刮伤
3. 避免与酸、碱及腐蚀性化学品接触
4. 储存于干燥、阴凉、通风处，避免高温或潮湿

全球方案: 在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859
service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIR500M1-0526